

2014年3月期 中間決算説明会

東京エレクトロン デバイス 株式会社

2013年10月29日

決算報告

代表取締役副社長

久我 宣之

2014年3月期中間修正予想と実績比較

(百万円)

	予想 2013.09.20 発表	実績 2013.10.28 発表	増減額	増減率
売上高	47,000	47,208	208	0.4%
経常利益	200	232	32	16.3%
中間純利益	170	214	44	26.0%

2013年9月20日発表中間業績予想との比較では
売上高・利益ともプラスで着地

業績 前期比較

(百万円)

	2013年3月期 中間	2014年3月期 中間	対前年比	
			増減額	増減率
売上高	42,866	47,208	4,341	10.1%
EC事業	35,899	40,294	4,395	12.2%
CN事業	6,966	6,913	▲ 53	▲ 0.8%
*1 売上総利益	7,286 (17.0%)	7,188 (15.2%)	▲ 98	▲ 1.3%
営業利益	688 (1.6%)	468 (1.0%)	▲ 220	▲ 32.0%
*2 経常利益	686 (1.6%)	232 (0.5%)	▲ 453	▲ 66.1%
中間純利益	406 (0.9%)	214 (0.5%)	▲ 192	▲ 47.3%
従業員数	954名	970名	-	-

※EC事業:半導体及び電子デバイス事業 CN事業:コンピュータシステム関連事業

売上高は、EC事業で車載機器が大幅増加 海外ビジネスも伸長

* 1 売上総利益率低下の要因

(百万円)

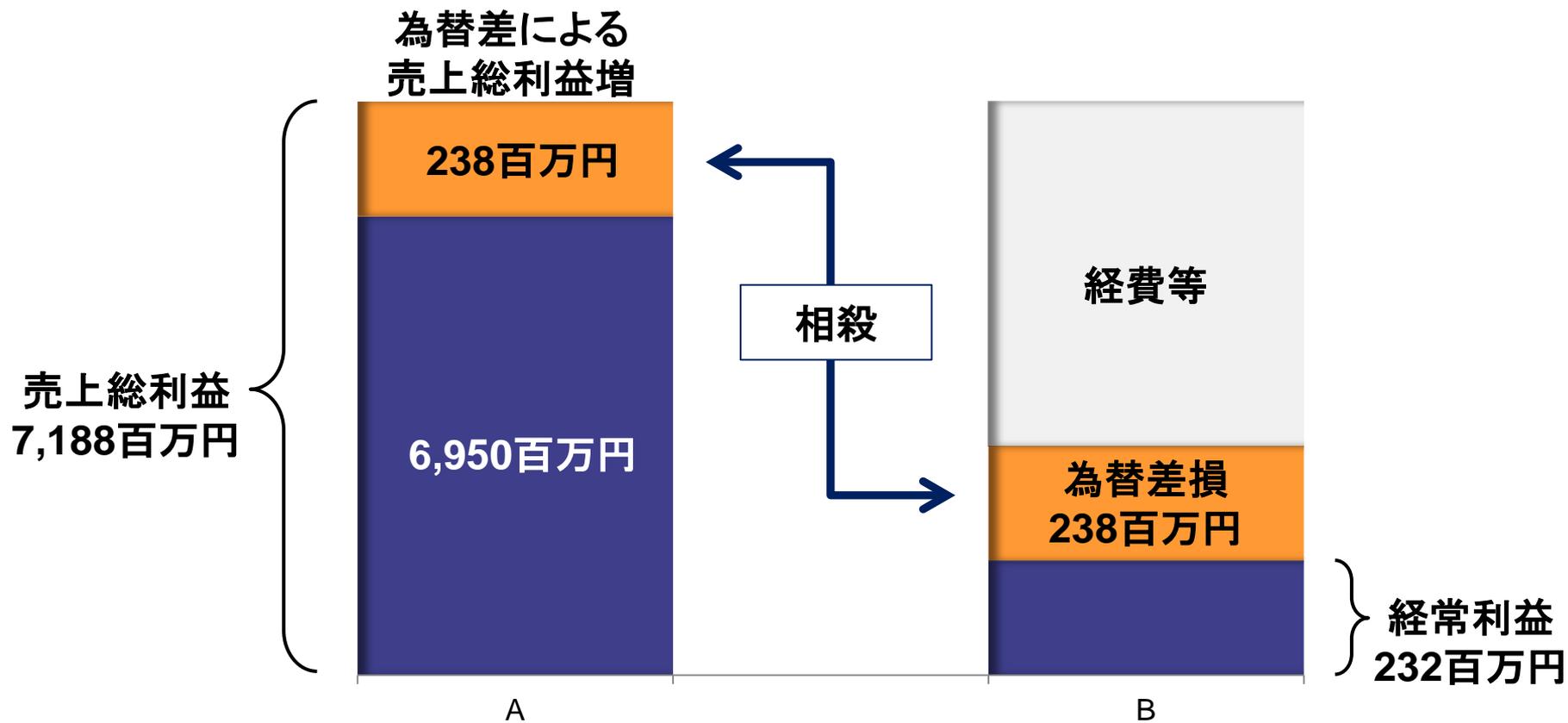
	2013年3月期 中間	2014年3月期 中間	対前年比	
			増減額	増減率
売上高	42,866	47,208	4,341	10.1%
EC事業	35,899	40,294	4,395	12.2%
CN事業	6,966	6,913	▲ 53	▲ 0.8%
売上総利益	7,286 (17.0%)	7,188 (15.2%)	▲ 98	▲ 1.3%

＜売上総利益率 1.8ポイント低下要因＞

EC事業：相対的に利益率の低い商品の構成比が上昇
海外売上構成比率上昇

CN事業：価格競争の激化により保守サービスで利益率低下

* 2 経常利益に与える為替変動の影響



円安進行時： 売上総利益が増加、為替差損が発生

セグメント別 売上高・利益

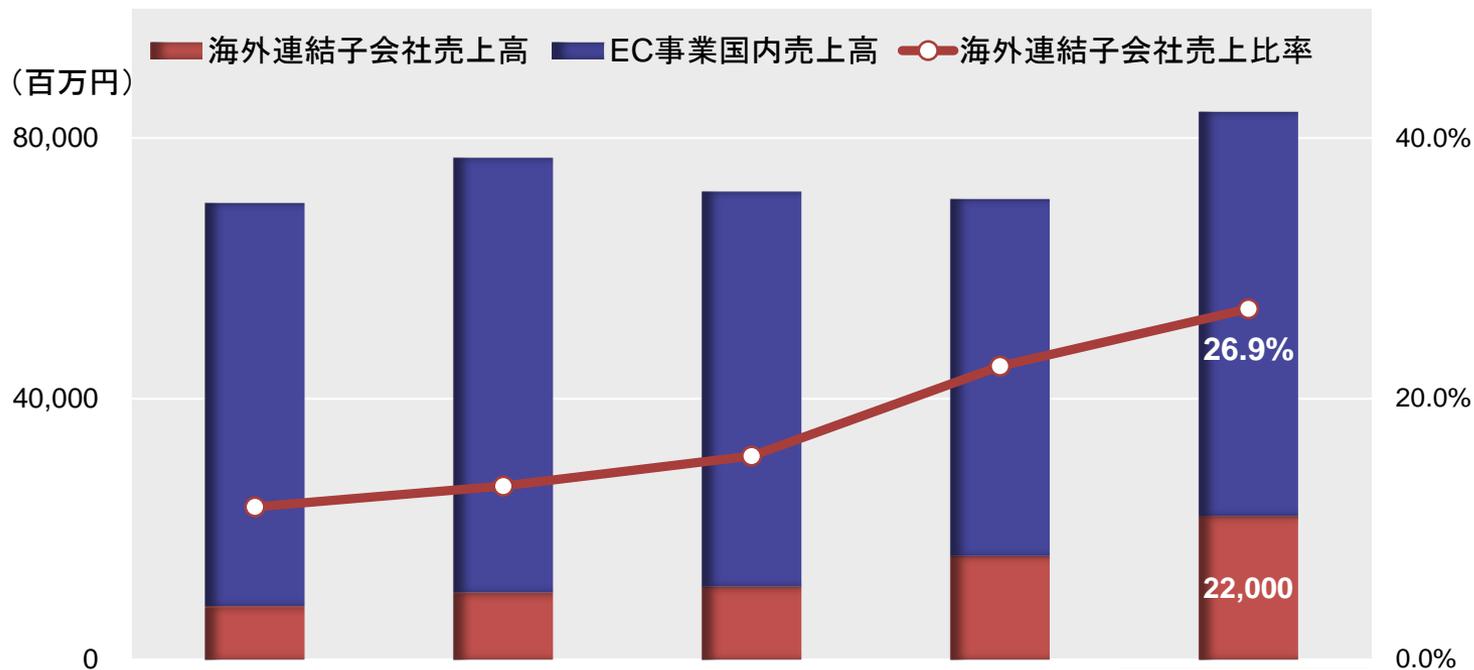
(百万円)

セグメント	2013年3月期中間		2014年3月期中間			
	売上高	セグメント利益	売上高	増減額 増減率	セグメント利益	増減額 増減率
EC事業	35,899	212	40,294	4,395 12.2%	▲178	▲391 -
CN事業	6,966	473	6,913	▲53 ▲0.8%	410	▲62 ▲13.2%
合計	42,866	686	47,208	4,341 10.1%	232	▲453 ▲66.1%

EC事業: 増収減益(前述した通り)

CN事業: 前期比減収減益も計画比では売上高・利益とも上振れ

海外連結子会社売上高



	10/3月期	11/3月期	12/3月期	13/3月期	14/3月期(予)
EC事業セグメント売上高	70,023	76,967	71,780	70,641	81,895
海外連結子会社売上高	8,186	10,265	11,172	15,868	22,000
海外連結子会社売上比率	11.7%	13.3%	15.6%	22.5%	26.9%

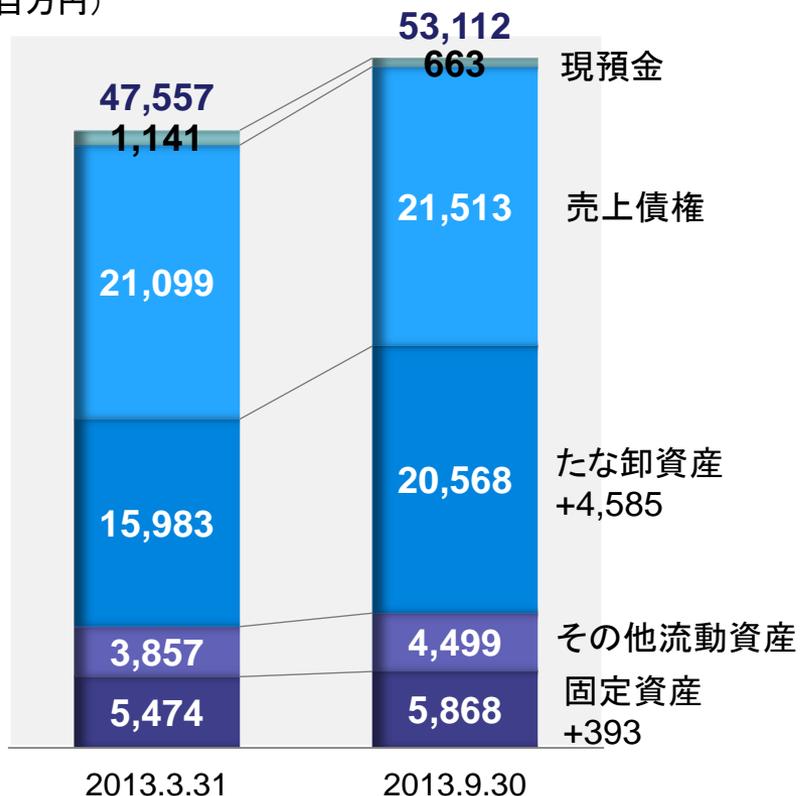
※海外連結子会社売上比率は EC事業セグメント売上高に対する海外連結子会社売上高の割合

中間売上高105億円(前年中間比33.5%増) 通期予想を220億円に上方修正

貸借対照表

➤ 資産

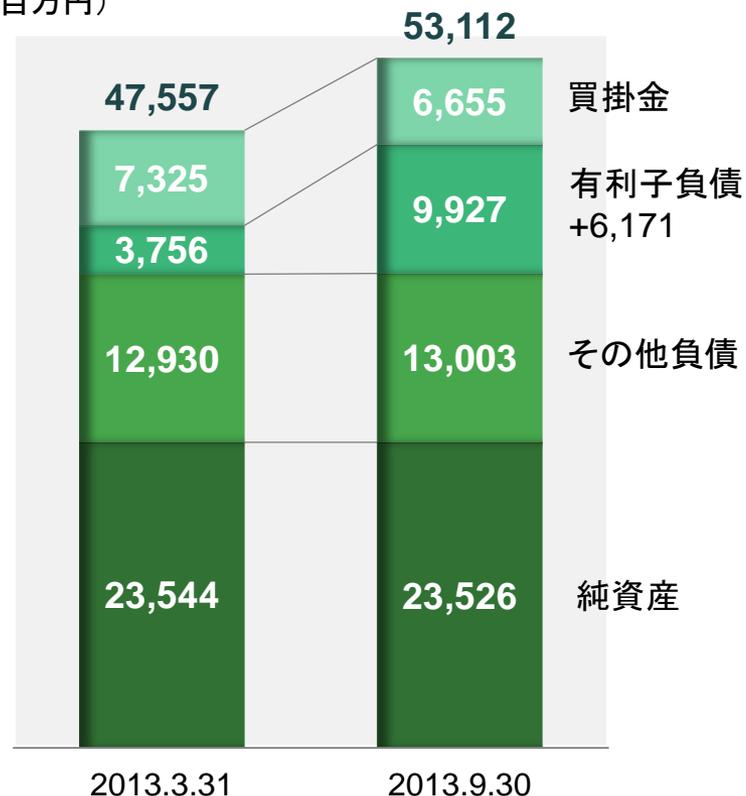
(百万円)



受注増加により たな卸資産増加
新基幹システムの導入等により固定資産増加

➤ 負債・純資産

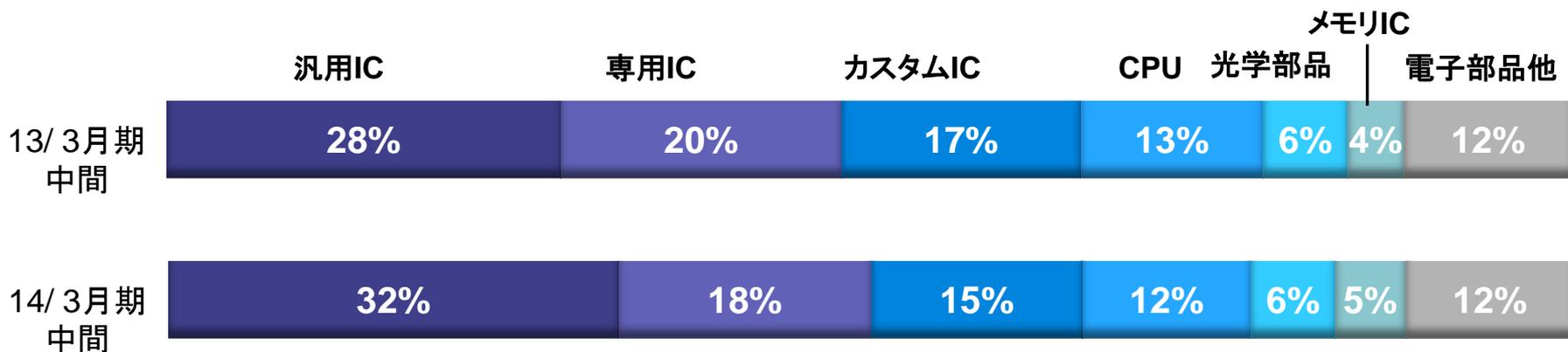
(百万円)



たな卸資産増加による運転資金を
有利子負債にて調達

セグメント情報 (EC事業)

➤ 品目別売上構成



商権拡大 新商材寄与 海外伸長等により全品目で売上高増加
特に汎用ICは 車載向け 家庭用ゲーム向け大幅増加

セグメント情報 (EC事業)

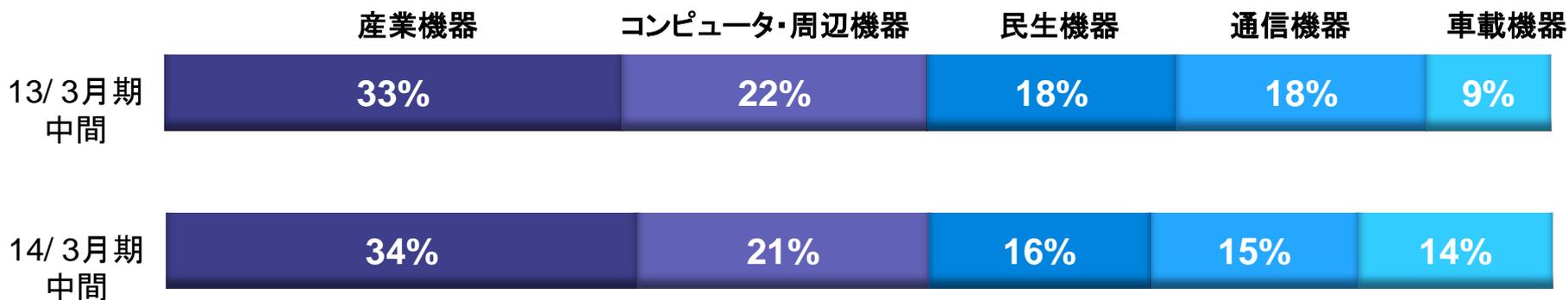
➤ 品目別売上増減

品目	対前年増減率	主な要因	主な仕入先
汎用IC	+30.3%	商権拡大により全分野で増加 特にカーナビゲーション 家庭用ゲーム増加	TI リニアテクノロジー
専用IC	+ 1.1%	TV大幅減小も 液晶プロジェクト等PC周辺機器増加	TI ピクセルワークス サイプレス インターシル リアルテック シリコンイメージ フリースケール インレビウム
カスタムIC	+3.1%	通信インフラ減少も 産業機器増加	ザイリンクス 富士通 インレビウム
CPU	+ 0.8%	通信インフラ減少も カーナビゲーション増加	TI フリースケール インテル
光学部品	+ 16.7%	産業機器増加	アバコ・テクノロジー
メモリIC	+21.5%	新商材の立ち上がりにより増加	サイプレス IDT スパンション
電子部品他	+ 9.0%	POS端末増加	マイクロソフト コーセル インレビウム

※仕入先名は略称で記載しております。

セグメント情報 (EC事業)

➤ 用途別売上構成



車載機器 がマーケットの堅調に加え商権拡大により大幅増加
産業機器 は回復基調
通信機器は通信インフラ低調

セグメント情報（EC事業）

➤ 用途別の傾向

用途	主なアプリケーション	当社の傾向
産業機器	医療機器 放送機器 監視カメラ FA機器 工業用ロボット 工作機械 半導体製造装置 インバーター 計測器	全般的に回復基調
コンピュータ・ 周辺機器	複合プリンター 液晶プロジェクタ OA機器 タブレット PC及び付属機器 POS	液晶プロジェクタ POS端末増加
民生機器	デジタルカメラ デジタルビデオカメラ TV DVD AV機器 家庭用ゲーム リモコン	TV大幅減小 家庭用ゲーム増加
通信機器	携帯電話 スマートフォン ルーター 伝送装置 基地局	通信インフラ減少
車載機器	カーナビゲーション カーオーディオ	カーナビゲーションがマーケット堅調に加え 商権拡大により大幅増加

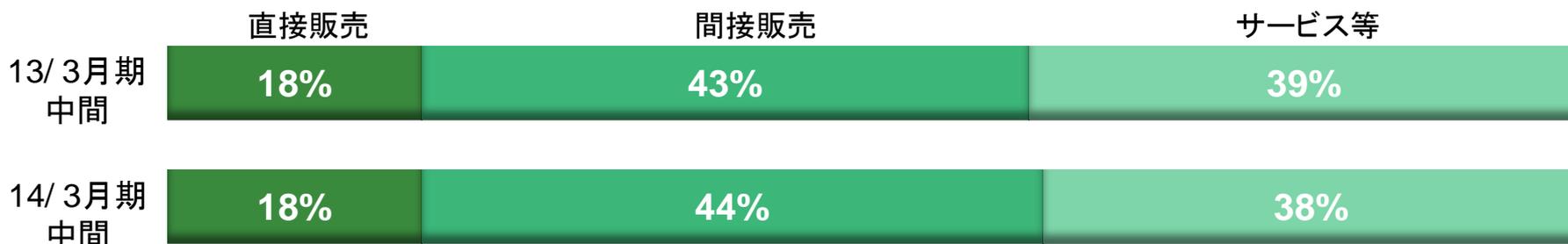
セグメント情報 (CN事業)

➤ 品目別売上構成



ネットワークは保守サービス減少も機器販売が伸長 売上高前年比 +5.7%
 ストレージは企業のIT投資低調を受け減少 売上高前年比 ▲2.8%

➤ 販売形態別売上構成



機器販売全体では若干増加 前年比+0.2% 直接販売▲0.8% 間接販売+0.6%
 保守サービスは競争激化に伴い減少 前年比 ▲3.6%

2014年3月期 活動方針と業績見込み

代表取締役社長

栗木 康幸

- ✓ 2014年3月期 活動方針及び取り組み
- ✓ 2014年3月期 業績見込み
- ✓ 配当について

EC事業の強化

- ◆ 海外ビジネスの拡大
- ◆ 自社商品(インレビアム)の拡大

CN事業の強化

- ◆ トータルソリューション提供への取り組み
- ◆ データサービス等の新事業領域への挑戦(追加)

新規事業への進出

- ◆ 環境・省エネルギー分野への取り組み
- ◆ 新規商材開拓および新商流構築

海外ビジネスの拡大-1

▶ 海外連結子会社売上高比率：EC事業の30%を目指す

inrevium

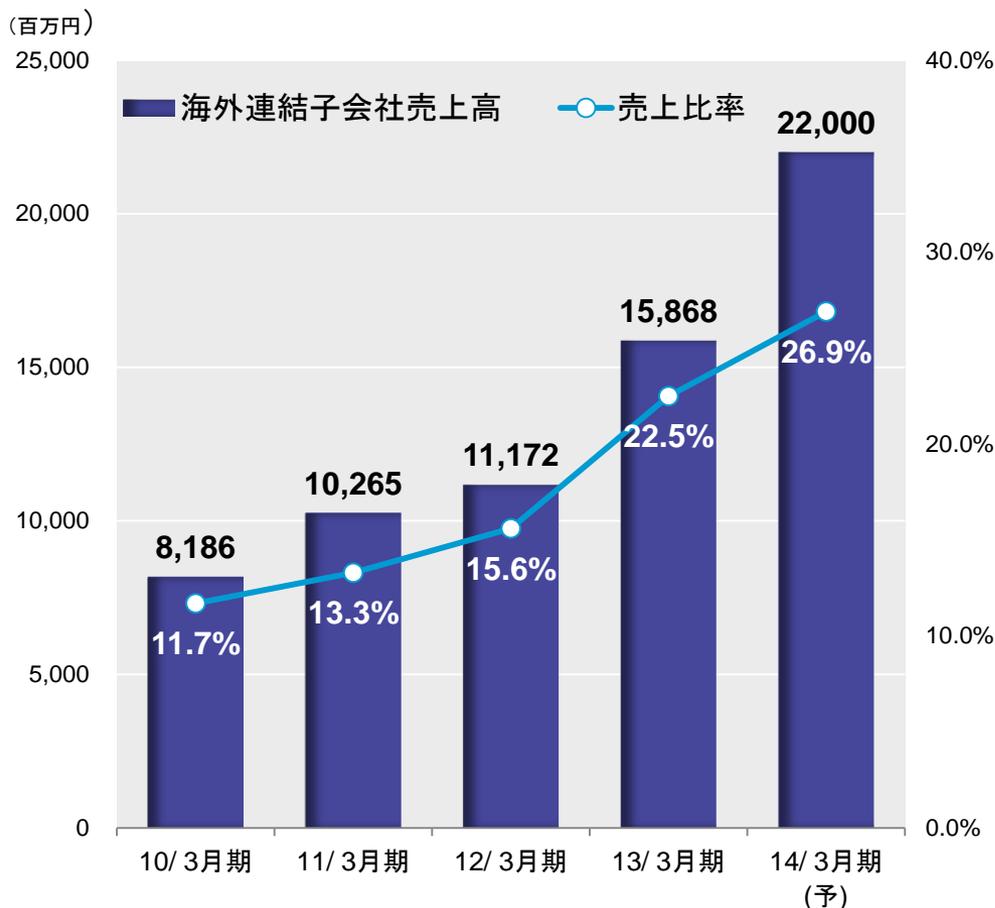
インレビウムアメリカ 設立

【設立の目的】

北米における現地販売体制の構築
インレビウム事業の拡大

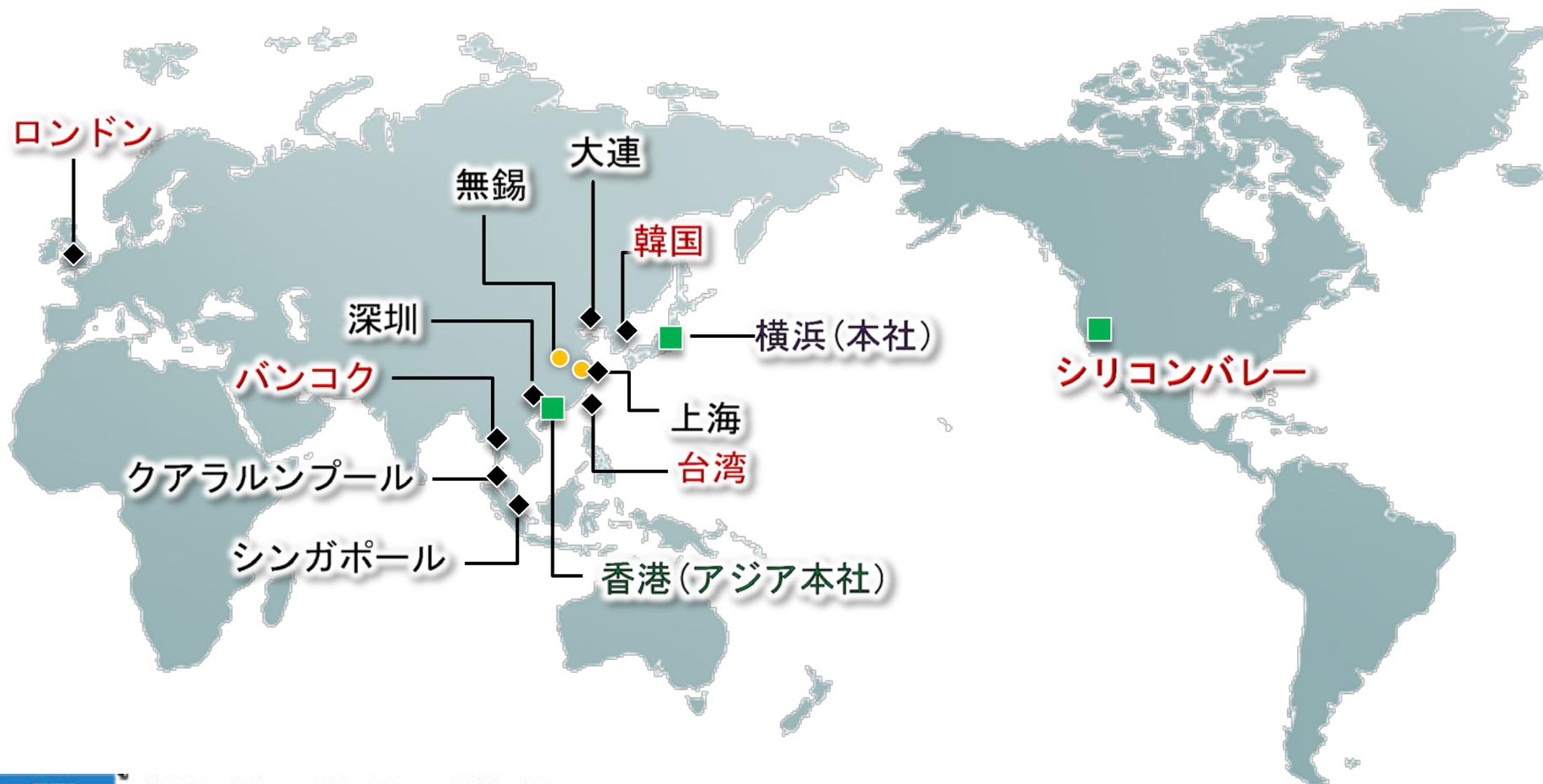
【会社概要】

商号：inrevium AMERICA, INC.
所在地：カリフォルニア州
シリコンバレー
設立：2013年9月
営業開始：2014年1月(予定)



海外ビジネスの拡大-2

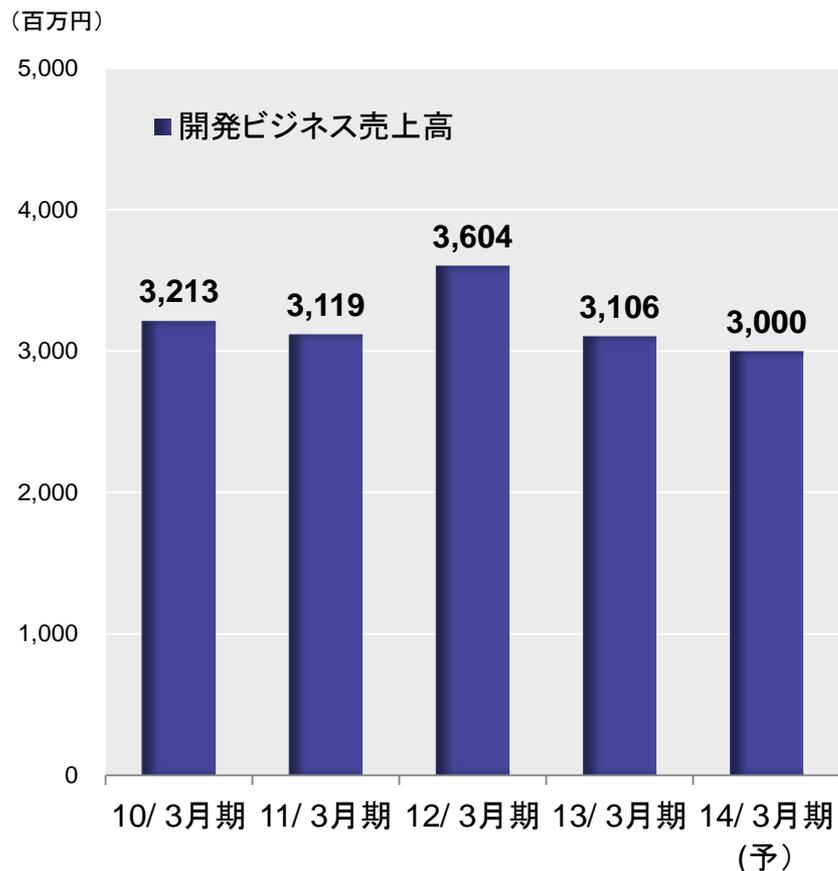
➤ 昨年度から新たに5拠点を開設



自社商品（インレビウム）の拡大



- 営業担当を海外に派遣、アプローチする地域・顧客を拡大
- 各地域での需要に合わせた商品・サービスを提供



海外販売体制

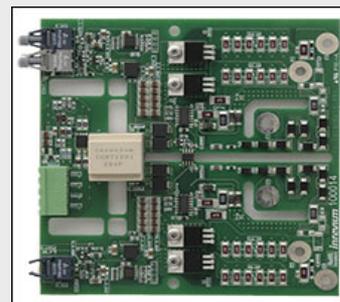
エリア

APAC地域 韓国 台湾
アメリカ ヨーロッパ (インド)

メンバー

海外拠点
設計開発拠点
現地パートナー企業

注力自社商品



IGBTゲートドライバ
光ファイバインタフェース搭載

<応用分野>
エネルギー制御
風力・太陽光など

- (独) 理化学研究所 X線自由電子レーザー施設「SACLA(さくら)」
- 東北大学ニュートリノ質量構造究明プロジェクト「カムランド禅」



自社商品(FPGA評価ボード)やシステム開発を受託

納入例



TD-BD-FMC-OPT4



TB-6V-LX240T-PCIEXP



TD-BD-FMC-FPGA-IOS475

SACLAセンサーカメラからデータをA/D変換し
光ファイバで転送するテスト
センサーから約100m離れた
場所でデータを受信し
汎用バスへ変換するテスト

トータルソリューション提供への取り組み

- クラウド環境に最適な製品群の拡充
- 技術サポート力の更なる向上

製品分類	特徴	対応製品
ネットワーク	高速、低コスト、省エネ スイッチ	 ARISTA
ストレージ	高速、大容量 ストレージ	 EMC ² PURE STORAGE
ミドルウェア	クラウドマネージメントシステム	 nicira by vmware basho
	技術サポート	運用支援サービス

データサービス等の新事業領域への挑戦

- 健康、嗜好、目的に合わせた献立を提案するWebアプリケーションサービス
- 7月30日より提供開始 iPhoneでも提供

The screenshot displays the Ohganic website interface. At the top, there's a navigation bar with the Ohganic logo and various utility icons like '提案献立', 'お気に入り', '買い物メモ', '基本設定', and 'アカウント'. Below the navigation, a section titled '今日の提案献立タイプはどれにしますか?' offers five categories: 'おまかせ', '定番料理', '食材選択', '体調管理', and '病氣予防'. A central button says '提案献立を見る'. The main content area features four meal cards with images and details: '豚肉とピーマンの甘酢いため', 'グリルチキンのさめめん', 'とりひき肉とコーンの肉だんご', and '牛肉とピーマンのオイスター...'. Each card includes calorie and time information. On the right side, there are three promotional boxes with 'OK!' stamps, highlighting features like 'Ohganicはココが便利!', '健康的で太りにくい!', and '買い物準備まで万全!'. At the bottom right, a small profile of a nutritionist is shown.



<システムの特徴>

従来とは異なるデータマネージメントと
高速データ処理システムを独自開発

バランスの良い献立メニューをリアルタイムで
提供することが可能

提案可能な献立は250万件以上
理論上は数百兆通りの献立提案が可能

Ohganic(オーガニック)サイト <https://ohganic.com>

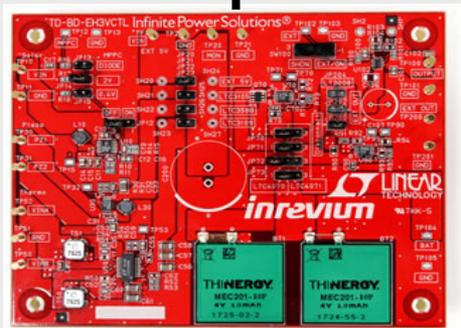
環境・省エネルギーへの取り組み

- 環境・省エネルギー分野の新たな商品ラインアップの拡充
- 顧客の開発支援

開発例



太陽光パネル



環境発電用 開発ボード
TD-BD-EH3VCTL

電力(電圧/ 電流/ 温度)モニタ
ワイヤレスセンサーネットワークの評価が可能



<応用分野>
安心・安全及び省エネ分野

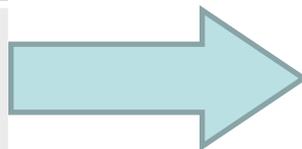
- エネルギー管理
- 道路、鉄道等都市インフラ
- 機器の状態・状況を管理
- 工程の監視・制御システム

新規商材開拓および新商流構築

- ▶ アジア地域での新規商材の発掘を行い 日本以外にも発信

アジア地域でマーケティング

韓国事務所・台湾事務所が中心
高機能パターン配線材(特許出願中)
基板材などの新商材を発掘



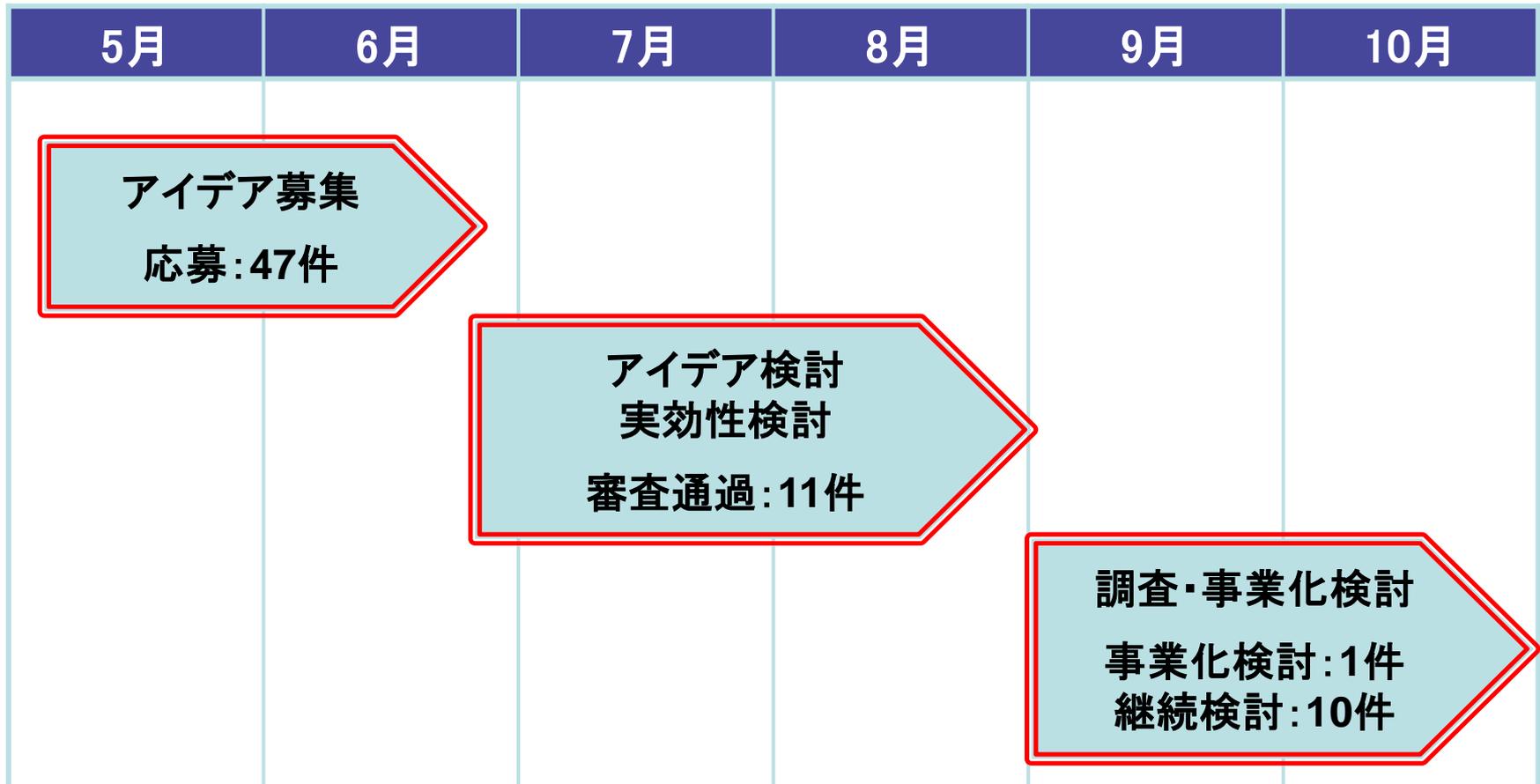
世界への発信源に

日本、アジア各国に加え
欧米諸国も視野に販売



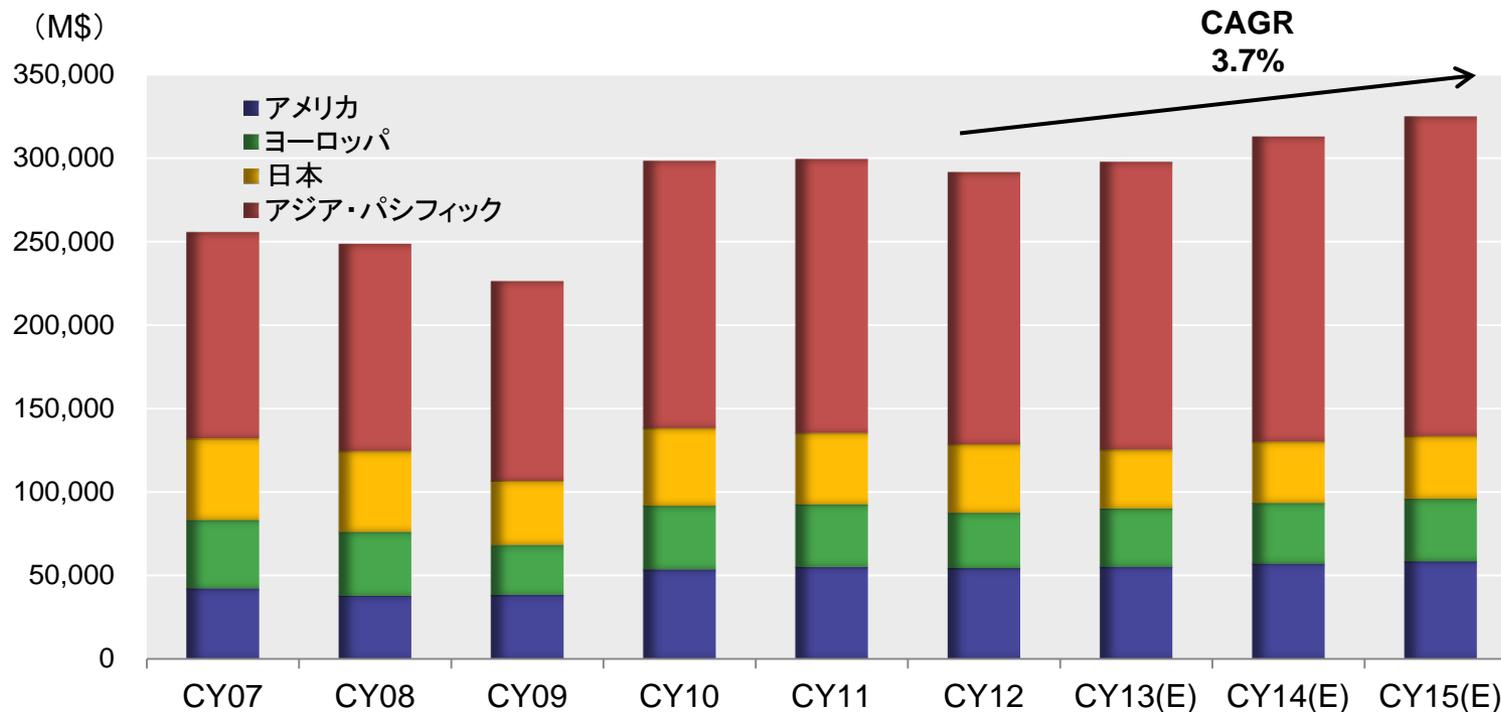
新規事業創出への取り組み

➤ 既存事業とは異なる新たな事業企画を社内公募



2014年3月期 業績見込み

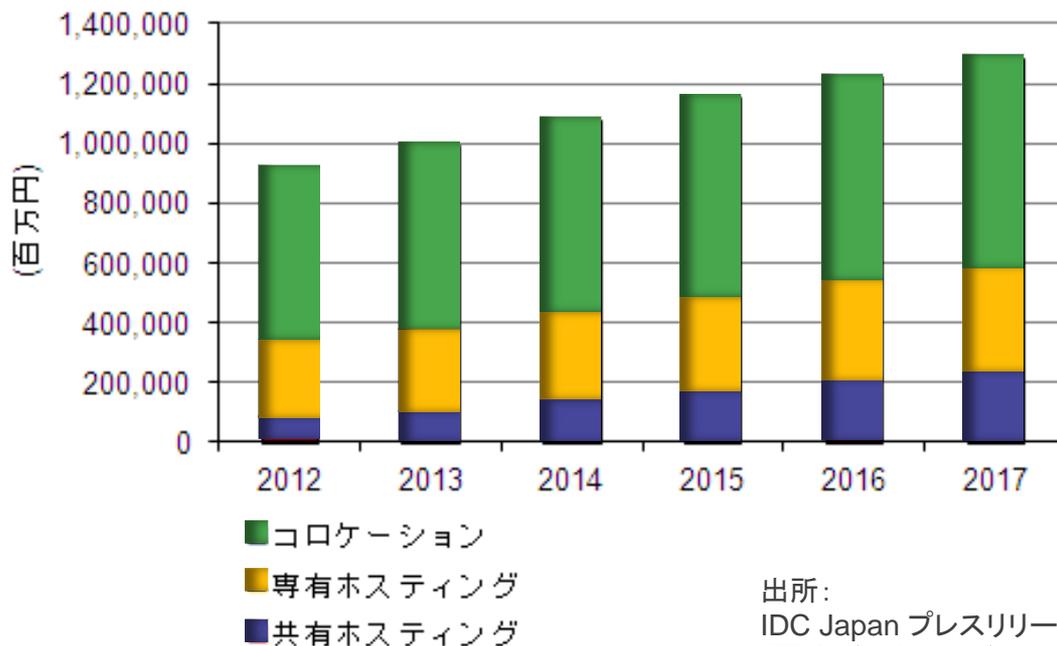
世界地域別半導体市場予測



出所: WSTS 2013年春季半導体市場予測
「世界地域別市場予測」 2013年6月

世界全体では緩やかに回復 アジア地域は成長持続

国内データセンターサービス市場 サービスカテゴリー別売上額予測



出所:
IDC Japan プレスリリース
「国内データサービス市場予測を発表」2013年10月1日

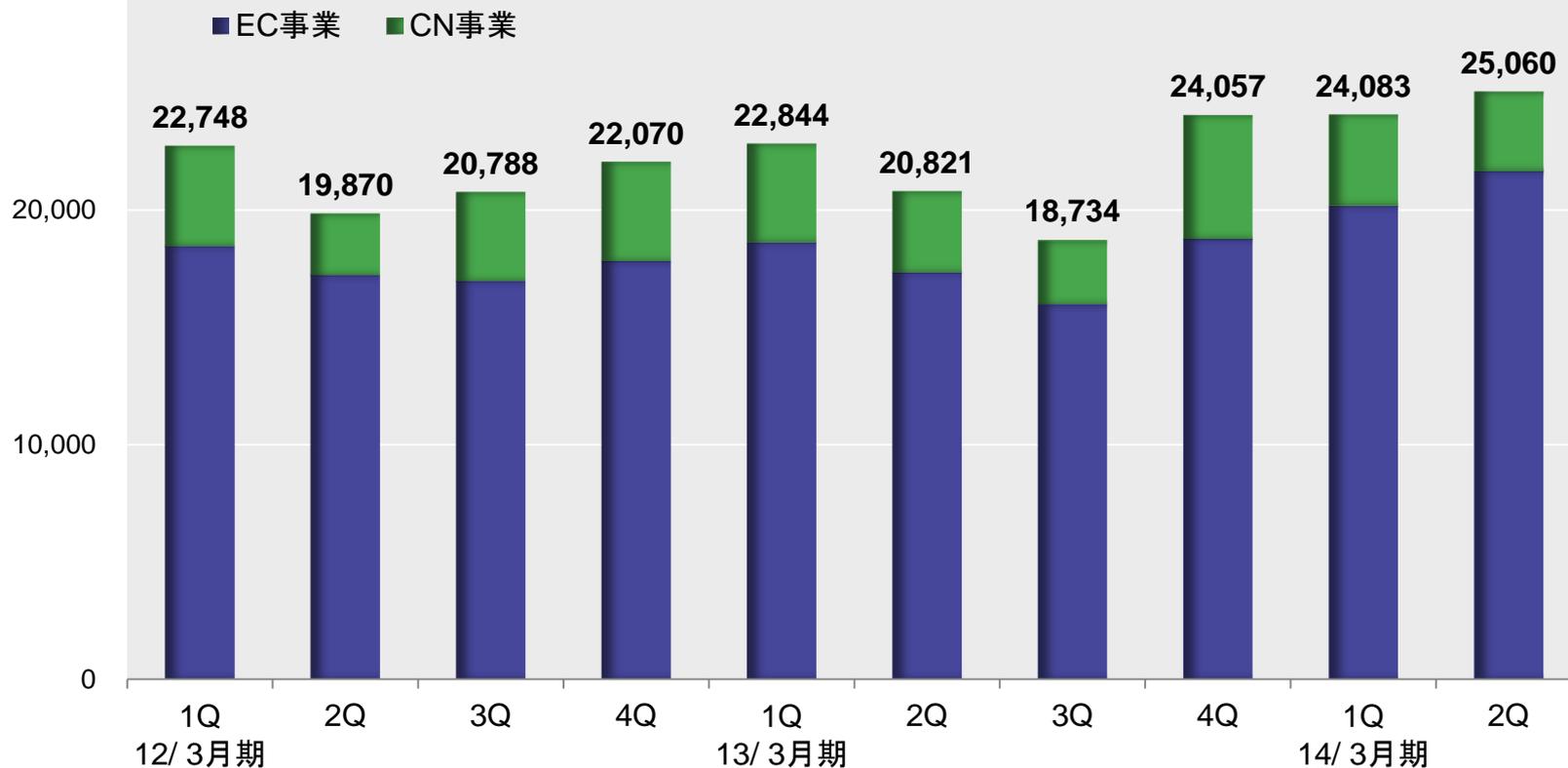
Note: 2012年は実績値、2013年以降は予測

2012年～2017年の年間平均成長率は7.0%
2017年市場規模は1兆2,831億円と予測

受注高推移

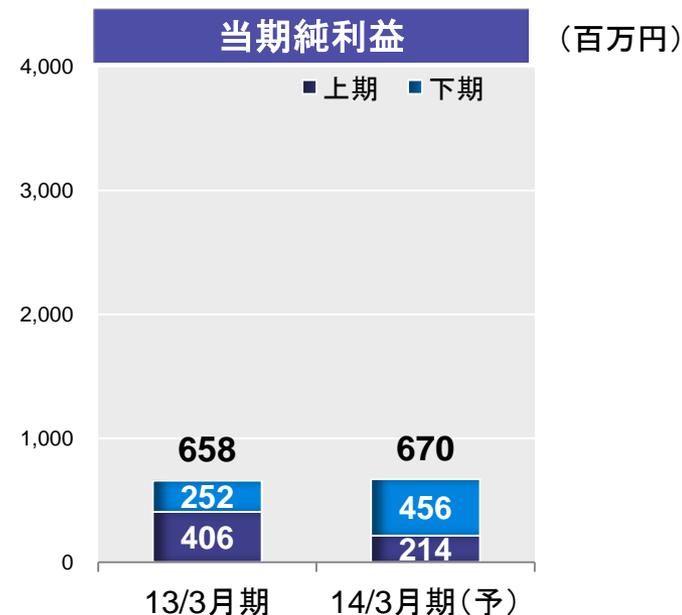
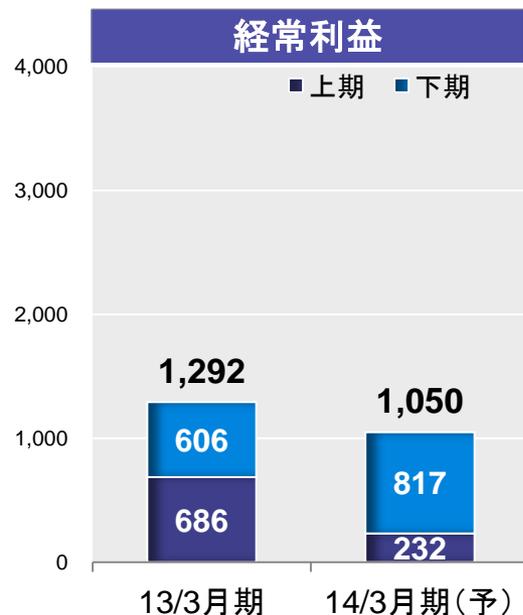
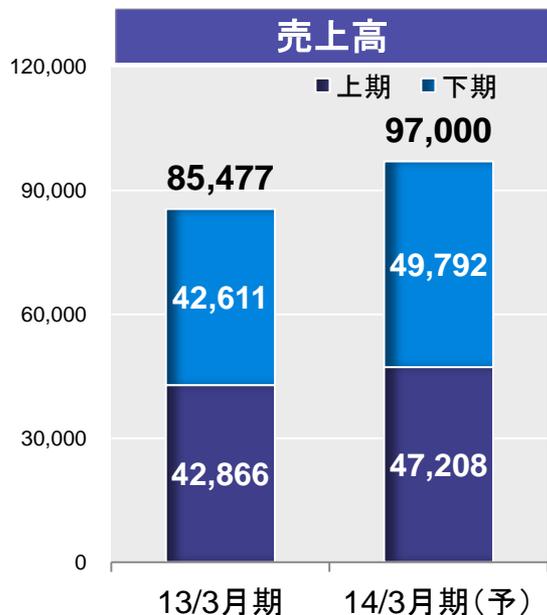
(百万円)

30,000



EC事業は2013年3月期 第4四半期より回復傾向
CN事業は通年でみるとコンスタントな推移

2014年3月期 業績予想



	2013年3月期	2014年3月期			対前年比	
	実績	上期実績	下期予想	通期予想	増減額	増減率
売上高	85,477	47,208	49,792	97,000	11,523	13.5%
EC事業	70,641	40,294	41,600	81,895	11,254	15.9%
CN事業	14,835	6,913	8,191	15,104	269	1.8%
経常利益	1,292 (1.5%)	232 (0.5%)	817 (1.6%)	1,050 (1.7%)	▲242	▲18.8%
当期純利益	658 (0.8%)	214 (0.5%)	456 (0.9%)	670 (1.0%)	12	1.7%

配当について

当期配当予想

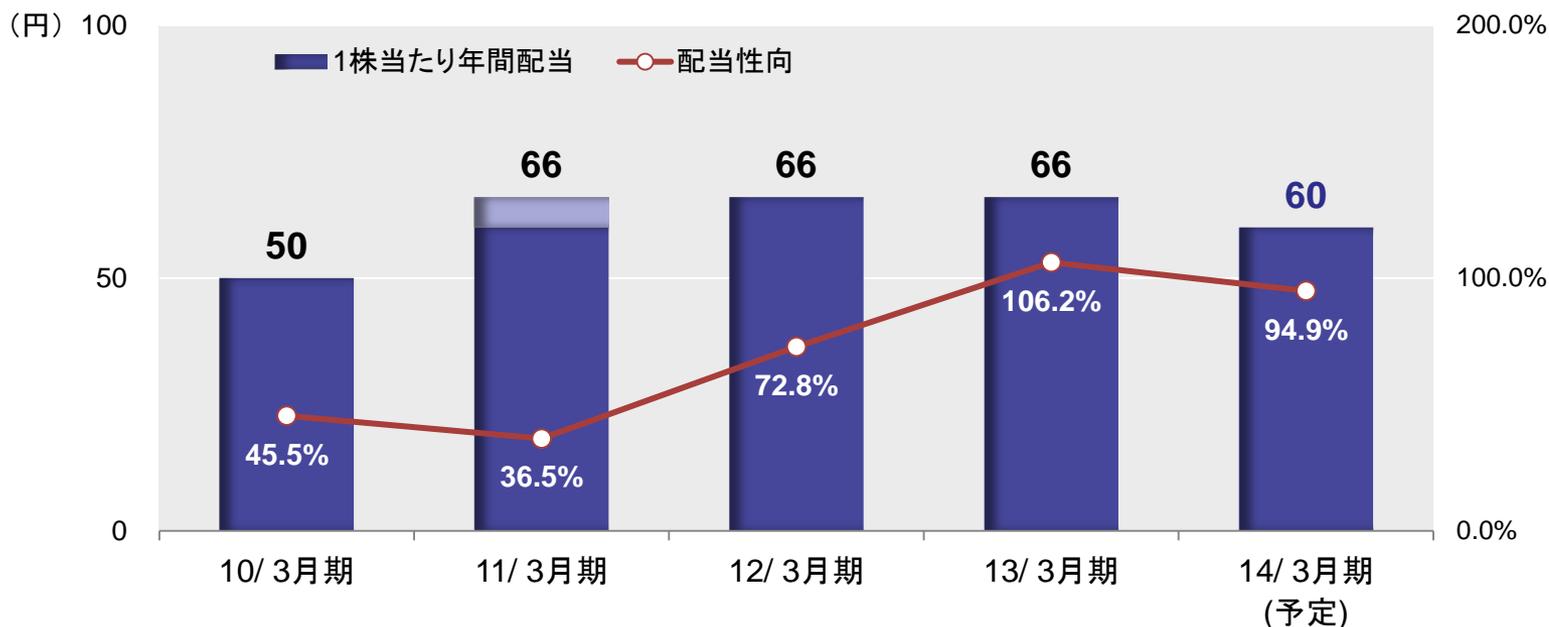
➤ 配当ポリシー

継続的かつ安定的な配当の実施を基本として、業績を反映した適正な利益還元を原則
当面の配当性向の水準については連結当期純利益の35%程度を目安

➤ 1株当たり年間配当金

中間配当：3,000円実施

期末配当予想：30円(2013年10月1日を効力発生日として1株を100株に分割)



* 上記1株当たり年間配当金額は 過去分まで遡及し 株式分割後の額で記載しております。

補足資料

品目 (EC事業)

品目	主な製品	機能
汎用IC	アナログIC ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
カスタムIC	ASIC PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
CPU	マイクロプロセッサ DSP	電子機器の頭脳 演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
メモリIC	SRAM FRAM MRAM フラッシュメモリ	記憶用IC 書込み読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
電子部品他	ソフトウェア ボード 電源 コネクタ	企業向け産業機器に組み込まれるソフトウェア プリント配線基板上にIC 電源 コネクタなどの部品を 実装した製品 (ボード)

品目 (CN事業)

品目	主な製品
ネットワーク関連機器	インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ) 企業向けネットワークシステム構築機器
ストレージ関連機器	SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など
ミドルウェア他	データウェアハウス用データベースソフトウェア 組み込みデータベース

仕入先

Technical Support
Development

セグメント	品目	主な仕入先
EC事業	汎用IC	リニアテクノロジー社 TI 社
	専用IC	コネクサントシステムズ社 サイプレス社 IDT社 インターシル社 メムシック社 ピクセルワークス社 リアルテック・セミコンダクター社 シリコンイメージ社 TI社 ビクシシステムズ社 インレピアム
	カスタムIC	富士通セミコンダクター(株) ザイリンクス社 インレピアム
	CPU	フリースケール・セミコンダクタ社 富士通セミコンダクター(株) インテル社 TI 社
	光学部品	アバゴ・テクノロジー社
	メモリIC	サイプレス社 IDT社 スパンション社
	電子部品他	コーセル(株) マイクロソフト社 インレピアム
CN事業	ネットワーク関連機器	エクストリームネットワークス社 F5ネットワークス社 インフォブックス社
	ストレージ関連機器	ブロード社 EMC社(アイシロン データメイン)
	ミドルウェア他	EMC社(グリーンプラム) オラクル社

※仕入先名は アルファベット順 略称で記載しております。

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界及びIT業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをご注意ください。
また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。